

お客様各位

PTN-SM1701
2017年4月24日
富士通セミコンダクター株式会社
システムメモリーカンパニー
品質保証部
部長 井上 憲一



製品終息について（通知）

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、貴社にご採用いただいております表記製品につきまして、後工程製造委託先より主要部材の終息通知があり、社内で検討した結果 対象製品を終息せざるを得ないという結論に至りました。

ご多用中誠に恐縮に存じますが、内容ご理解・ご賢察の上、ご査収お願い申し上げます。

敬 具

- 記 -

1. 対象製品

・弊社型格： MB85R256FPF-G-BNDE1

2. 終息理由

・当該製品の組立工程における主要部材が終息するため。

3. 依頼事項

・本品種の終息に伴い、最終所要を取りまとめの上、発注をお願い致します。

最終オーダー日：2017年10月20日

最終出荷予定日：2018年4月30日

ご参考：終息品と同容量品とのFRAMとして MB85R256FPNF-G-JNE2 がございます。
終息品とは外形寸法が異なりますのでご検討際にはご注意願います。

以 上